THICK FILM (PRECISION)





外装色:黒(1F.1H).

青 (1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A) Coating color : Black (1F, 1H), Blue (1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A)

■特長 Features

小型・軽量です。

- ●抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
- 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を 有しています。
- テーピング等の各種自動実装機に対応します。
- リフロー、フローはんだ付けに対応します。
- 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応です。電極、抵抗、ガ ラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
- AEC-Q200に対応(データ取得)しています。(1Fを除く)
- Small size and light weight.
- Excellent heat resistance and weather resistance are ensured by the use of metal glaze thick film.
- High stability and high reliability with the triple-layer structure of electrode.
- Applicable to various kinds of automatic mounters for taping, etc.
- Suitable for both flow and reflow solderings.
- Products with lead free termination meet EU-RoHS requirements. EU-RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.
- AEC-Q200 qualified (Exemption 1F).

■品名構成 Type Designation

例 Example



※2 金めっき電極品は、1E、1J、2A (10Ω~1MΩ) で対応しております。 仕様が若干異なりますので、弊社までご相談ください。
※3 1F、1H、W2H、W3Aは端子表面材質Tのみを対応致します。
※2 Products with gold plated electrodes are also available with 1E, 1J and 2A types (10Ω~1MΩ), so please consult with us.

- types (10 α -1MG), so please consult with us. %3 With type 1F, 1H, W2H, W3A only T is available as the terminal surface
- material
- 端子表面材質は鉛フリーめっき品が標準となります
- 関連負債物資含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合に はお問合せください。 テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。

The terminal surface material lead free is standard. Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-ROHS. For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back

■構造図 Construction



■外形寸法 Dimensions

形名 Type		Weight(g)					
(Inch Size Code)	L	W	с	d	t	(1000pcs)	
1F (01005)	0.4±0.02	0.2±0.02	0.10±0.03	0.11±0.03	0.13±0.02	0.04	
1H (0201)	0.6±0.03	0.3±0.03	0.1 ± 0.05	0.15±0.05	0.23±0.03	0.14	
1E (0402)	$1.0\substack{+0.1\\-0.05}$	0.5±0.05	0.2±0.1	$0.25\substack{+0.05\\-0.1}$	0.35±0.05	0.68	
1J (0603)	1.6±0.2	0.8±0.1	0.3±0.1	0.3±0.1	0.45±0.1	2.14	
2A (0805)	2.0±0.2	1.25±0.1	0.4±0.2	0.3 ^{+0.2} _{-0.1}	0.5±0.1	4.54	
2B (1206)	20+00	1.6±0.2		$0.4^{+0.2}_{-0.1}$		9.14	
2E (1210)	3.2±0.2	2.6±0.2	0.5±0.3	0.4-0.1	0.6±0.1	15.5	
W2H (2010)*1	5.0±0.2			0.65±0.15	0.6±0.1	24.3	
W3A (2512) ^{**1}	6.3±0.2	3.1±0.2		0.65±0.15		37.1	

※1 RK73H 2H and RK73H 3Aも対応致します("d"寸法が異なります。"d"寸法=0.4^{+0.2}mm) *1 RK73H 2H and RK73H 3A are also still available (different "d" dimensions=0.4^{+0.2}_{-0.1}mm)

■負荷軽減曲線 Derating Curve

周囲温度 Ambient temperature



周囲温度70℃以上で使用される場合は、 上図に 示す負荷軽減曲線に従って、定格電力を軽減し て御使用ください。

For resistors operated at an ambient temperature of 70° C or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

端子部温度 Terminal part temperature



上記の端子部温度以上で使用される場合は、 荷軽減曲線に従って定格電力を軽減してご使用 ください。 ※ご使用方法につきましては巻頭の"端子部温

度の負荷軽減曲線の紹介"を参照願います。

For resistors operated terminal part temperature of described for each size or above, a power rating shall be derated in accordance with derating curve.

*Please refer to"Introduction of the derating curves based on the terminal part temperature on the beginning of our catalog before use.

■参考規格 Reference Standards IEC 60115-8 JIS C 5201-8 EIAJ RC-2134C

本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。ご注文およびご使用前に納入仕様書で内容をご確認ください。 車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器へのご使用を検討される場合には、必ず事前にご相談ください。 Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotives, medical equipment and aerospace equipment. Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.

Oct. 2015

■定格 Ratings

形 名 Type	定格電力 Power Rating	定格 周囲温度 Rated Ambient		抵抗温度 係数 T.C.R.	抵抗値 Resistance D:±0.5%	Range (Ω) F:±1% F:±1%		最高 過負荷電圧 Max. Overload		二次加工と包装数/リール Packaging & Q'ty/Reel (pcs)					
	nating	Temp.	Part Temp.	(×10 ⁻⁶ /K)	E24 · E96	E24 · E96	voltage	Voltage	TX	TBL	TA	TC·TCM	TPL·TP	TD	TE
1F	0.03W	70°C	_	±200 ±250	_	100k~1M*4 10~91k*4	20V	30V	40,000	20,000	_	-	_	_	_
1H	0.05W	70°C	_	±200 ±400	10~1M _	10~10M ^{#4} 1~9.1 ^{#4}	25V	50V	_	_	35,000	TC :10,000 TCM:15,000	_	_	_
1E	0.1W	70°C	125℃	±100 ±200	10~1M —	10~1M 1~9.76 1.02M~10M	50V		_	_	-	_	TPL:20,000 TP :10,000	_	_
1J	0.1W	70℃	125°C	±100 ±200	1.02k~1M —	1.02k~1M 1.02M~10M	75V	100V	_	_		_	TP :10,000	5,000	
10	0.125W	,00		±100 ±200	10~1k 	10~1k 1~9.76									
2A	0.25W	70℃	125℃	±100 ±200 ±400	10~1M —	10~1M 1~9.76 1.02M~10M	150V	200V	_	-	-	-	TP :10,000	5,000	4,000
2B	0.25W	70°C	125°C	± 100 ± 100 ± 200 ± 400	10~1M —	10~1M 1~9.76 1.02M~5.6M			_	_	_	_	_	5,000	4,000
2E	0.5W	70℃	125℃	$\pm 400 \\ \pm 100 \\ \pm 200 \\ \pm 400 \\ \pm 400 \\ \pm 100 \\ \pm 10$	10~1M —	5.62M~10M 10~1M 1~9.76 1.02M~5.6M 5.62M~10M	200V	400V		_	_	_	_	5,000	4,000
W2H	0.75W	70℃	125℃	± 100 ± 100 ± 200 ± 400	10~1M —	10~1M 1~9.76 1.02M~5.6M 5.62M~10M			-	-	_	-	_	_	4,000
W3A	1W	70℃	125°C	±100 ±200 ±400	10~1M —	10~1M 1~9.76 1.02M~5.6M 5.62M~10M	200V (500V*5)	400V (500V*5)	_	_	_	_	_	_	4,000

使用温度範囲 Operating Temperature Range :ー55℃~+125℃ (1F)、-55℃~+155℃ (1H・1E・1J・2A・2B・2E・W2H・W3A)

定格電圧は√定格電力×公称抵抗値による算出値、又は表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となります。

Rated voltage=\sqrt{Power Rating \times Resistance value} or Max. working voltage, whichever is lower.

ジャンパーチップはRK73Zシリーズを参照ください。

For flat chip jumper resistor, please refer to RK73Z series. **4 RK73H1F(F: ±1%)及びRK73H1H($1\Omega \leq R \leq 0.1\Omega$, $1M\Omega \leq R \leq 10M\Omega$)の公称抵抗値はE24となります。 **5 ()内の最高使用電圧、最高過負荷電圧については、お問い合わせください。 **4 The nominal resistance value for RK73H1F(F: ±1%) and RK73H1H($1\Omega \leq R \leq 9.1\Omega$, $1M\Omega \leq R \leq 10M\Omega$) is E24.

*5 Please consult with us about the Max. working voltage and the Max. overload voltage with (

AS Fields Construction with as about the max. Working voltage and the max working voltage with (1). お客様の使用状況において、定格周囲温度、定格端子部温度のどちらを使用するか疑義が生じる場合は定格端子部温度を優先してください。 詳細は14~17頁の「端子部温度の負荷軽減曲線の紹介」をご参照ください。 If any questions arise whether to use the "Rated Ambient Temperature" or the "Rated Terminal Part Temperature". Terminal Part Temperature".

For more details, please refer to "Introduction of the derating curves based on the terminal part temperature" in page 14 to 17.

■性能 Performance

試験項目 Test Items	規格値 Performance Requirer $\Delta R \pm (\% + 0.1 \Omega)$	nents	試験方法 Test Methods		
Test tients	保証値 Limit 代表値 Typical		Test Methous		
抵抗值 Resistance	規定の許容差内 Within specified tolerance	_	25°C		
抵抗温度係数 T.C.R.	規定值内 Within specified T.C.R	-	+25°C/-55°C and +25°C/+125°C		
過負荷(短時間)	2	1 : 1F	定格電圧×2.5倍を5秒印加(1E、2Bは定格電圧×2倍)		
Overload(Short time)		0.5 : another	Rated voltage×2.5 for 5s(1E, 2B:Rated voltage×2 for 5s)		
はんだ耐熱性	1 : 1F~W3A (10Ω≦R≦1MΩ)	0.5 : 1F~W3A (10Ω≦R≦1MΩ)	260°C±5°C, 10s±1s		
Resistance to soldering heat	3 : 1H~W3A (R<10Ω, R>1MΩ)	1 : 1H~W3A (R<10Ω, R>1MΩ)			
温度急変	1 : 1F	0.5 : 1F	-55°C (30min.)/+125°C (30min.) 100 cycles		
Rapid change of temperature	0.5 : another	0.3 : another			
耐湿負荷 Moisture resistance	2 : 1J, 2A, 2B 3 : another	0.75 : 1J, 2A, 2B 1.5 : 1F 1 : another	40℃±2℃, 90%~95%RH, 1000h 1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle		
70℃での耐久性	2 : 1J, 2A, 2B	0.75 : 1J, 2A, 2B	70℃±2℃, 1000h		
Endurance at 70℃	3 : another	1 : another	1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle		
高温放置	1	0.5 : 1F	+125℃, 1000h : 1F		
High temperature exposure		0.3 : another	+155℃, 1000h : 1H, 1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A		

■使用上の注意 Precautions for Use

●チップ抵抗器の基材はアルミナです。実装する基板との熱膨張係数の違いから、ヒートサイクル等の熱ストレスを繰り返し与えた場合、接合部のはんだ(はんだフィレット部)に クラックが発生する場合があります。特にW2H・W3Aの大型タイプの場合、熱膨張が大きく、また、自己発熱も大きいことより、周囲温度の変動が大きく繰り返される場合や、 負荷のオンオフが繰り返される場合は、クラックの発生に注意が必要です。一般的なヒートサイクル試験をガラエボ基板(FR-4)を用い、使用温度範囲の上限・下限で行った場合、 1F~2Eのタイプでは、クラックは発生しにくいですが、W2H・W3Aタイプは、クラックが発生しやすい傾向にあります。熱ストレスによるクラックの発生は、実装されるラン ドの大きさ、はんだ量、実装基板の放熱性等に左右されますので、周囲温度の大きな変化や負荷のオンオフの様な使用条件が想定される場合は、十分注意して設計してください。 ● RK73H1Fでは機器組立工程における静電気の発生・印加により抵抗器が損傷する場合がありますのでご注意ください。

• The substrate of chip resistors is alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat stress like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the cracks when the change in ambient temperature or ON /OFF of load is repeated, especially when large types of W2H/W3A which have large thermal expansion and also self heating. By general temperature cycle test using glassepoxy (FR-4) boards under the maximum/minimum temperatures of operating temperature range, the crack does not occur easily in the types of $1F \sim 2E$, but the crack tends to occur in the types of W2H/W3A. The occurrence of the crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and conditions for use like ON/OFF of load can be assumed.

• Care should be taken that RK73H1F may be damaged when static electricity occurs and is applied in the equipment.